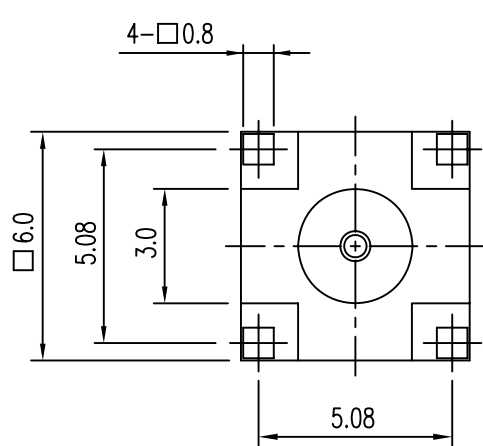
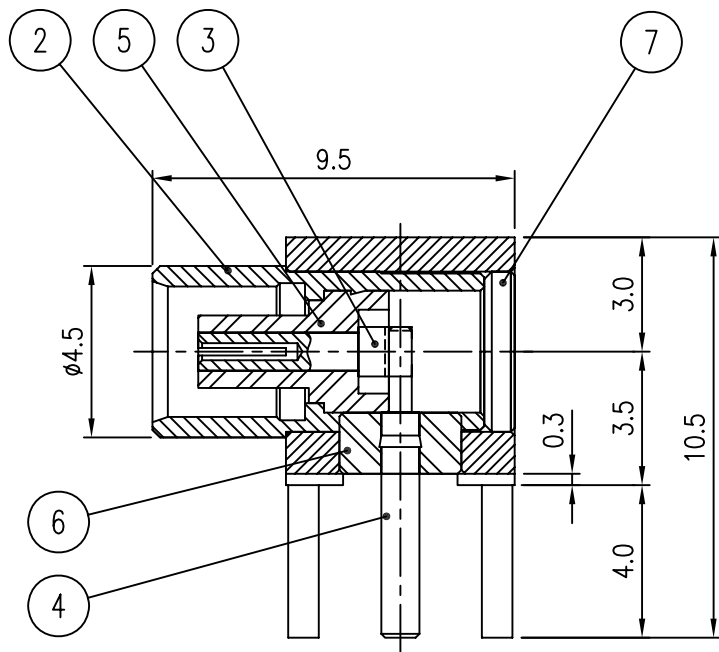



수 정 내 용									
ST	가	리	기	기	기	기	기	기	기
ST(기준)									
ST(개선)									

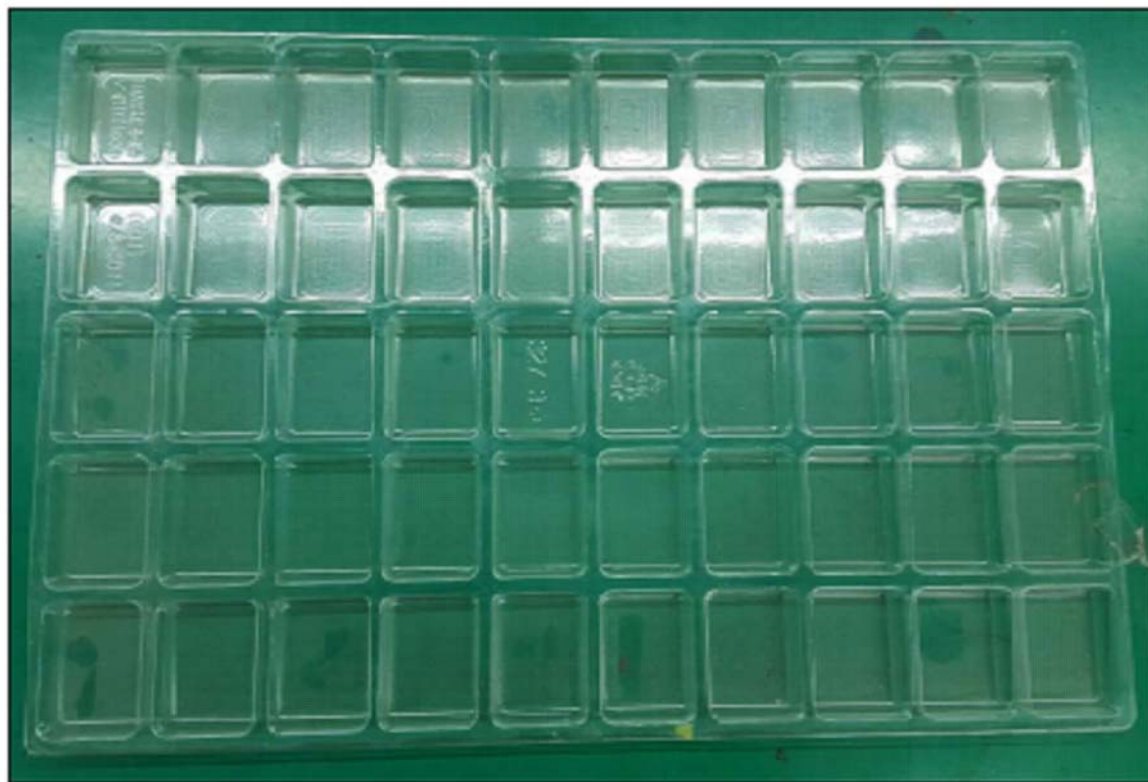
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	[실변No.201809-0004] 조립성 개선으로 인한 BODY 뒤편배를 추가	은선영	김인철	2018. 09. 17



* 포장사양 2Page 참조 *

7	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCO00017-5/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00020-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00049-N/1
4	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00023-5/1
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00030-5/1
2	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBB00037-5/1
1	사각 BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00064-1/1 DBD00050-3/1

대체가능재질	품 번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고	
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2001. 11. 6.					<div> RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.</div>			
	승인								
	검도								
재질 _____	재도					도명 MCX50 PCB JL-4R			
열처리 _____	작성부서 연 구 소								
보호파막처리 _____	작도	5/1	단위	mm	총량	A4	도번 CN00733-7/1		
							K313-665-000		



* CN00733-7/1 포장사양 *

1. 부광하이텍 327-3호 (PET) Tray 사용
2. Tray 개당 제품 5ea씩 포장하여,
Total 250ea 포장